半導体パッケージング、 基板実装分野の トッププレイヤーが集結

Advanced Packaging and **Chiplet Summit**

APCS 2024スポンサー



















同時

展示

業界をリードする主要 企業による最新技術、 サービスの展示

カンファレンス

パッケージング、設計 業界の世界のトッププ レーヤーが多数講演

ADIS

ネットワーキング

APCS、ADIS両方の講 演者、出展者、委員等 関係者が参加

次世代の半導体設計と 検証分野にフォーカスする 新たなサミット

Advanced Design Innovation Summit 会場 東京ビッグサイト

日時 2024.12.11[Wed] »13[Fri]

10:00 > 17:00



導体の未来が ここにある。

会場 東京ビッグサイト(東ホール・会議棟)

日時 2024.12.11[Wed] >>> 13[Fri] 10:00 > 17:00

主催 semi



SEMICON® JAPAN

戦略・技術・ビジネス・人材すべてが集う

展示

半導体サプライチェー ンをつなぐ国内外の主 要企業が一堂に集結

セミナー

トップエグゼクティブを 含めた250名以上の登 壇者による60を超える プログラム

ネットワーキング

リアルイベントだから こそ生まれるリアルな コミュニケーションと ビジネス創出の機会

若手応援企画

業界の未来を担う後進 の育成を支援するプロ グラムの数々

SEMICON Japan 2024 スポンサー

一プラチナスポンサー —













一 ゴールドスポンサー 一





















- Workforce Development スポンサー -

HORIBA

muratec



TRENG.

お問合せ

SEMICON Japan 2024 お問合せ窓口

Email: semicon@operation-desk.jp Tel: 03-3292-5541

開設期間:10/2(水)~12/13(金)平日のみ10:00~17:00

SEMICON Japanだから実現した、世界のトップエグゼクティブ・エキスパートによる珠玉のセミナーをお見逃しなく

注目のキーノート

Opening Session

1兆ドル半導体市場への挑戦~我々半導体業界は何を目指すべきか、 SEMICON Japan 2024の基調をなすメッセージ。

▶ AI が切り開く新しい半導体市場

~ AIチップリーディングカンパニーが描く未来戦略~日本政府、最先端ロジッ クファウンドリ、AI技術をリードする米国企業のトップが登壇。

Executive Summit

1兆ドル市場へ向けたグローバルリーディングカンパニーの成長戦略~世界を 代表する半導体業界トップエグゼクティブが語る。

業界の第一線で活躍するスピーカー陣

▶ 半導体新時代の戦略と技術

世界のTOPチップ製造企業の企業戦略、サプライチェーン戦略、注力技術。

▶ ハイパフォーマンス・コンピューティング時代の半導体技術

HBメモリ、プロセッサ、製造技術の最新動向~ハイパフォーマンス・コンピュー ティング (HPC) の基盤となる最先端の半導体の技術展望とは?

▶ Grand Finale ~1兆ドル半導体市場への展望~

東3ホール

FLEX

2030年に向けた「基本戦略」の進捗、世界の半導体政策・各国が打ち出す具 体的政策とは?

東2ホール

SuperTHEATER

東1ホール

APCS

Market/Advocacy

マーケット/ アドボカシー

SEMI

MARKET

最新の半導体市場動向をビジネ スにフォーカスし行政、リサーチ ャー、アナリストなど各分野のス ペシャリストが語る

【セミナー】

- SEMIマーケットフォーラム
- 半導体材料フォーラム
- Bulls & Bears
- 世界市場における 日本半導体産業の競争力

Sustainability

サステナビリティ

サステナビリティサミットでの官民 のキーノートスピーチ、PFASや半 導体気候関連コンソーシアム (SCC)の活動報告、サステナビリ ティハブにて各社の出展も

【セミナー】

- サステナビリティサミット
- 国際 EHS 規制適合セミナー



ADIS Advanced Design Innovation Summi

Technology

セミナーや展示

テクノロジー

APCS® Advanced Packaging and Chiplet Summit

次世代の半導体設計と検証分野にフォーカスする新たな サミット。最新技術の展示エリア、設計業界の現状や課題 などについて徹底議論するカンファレンス、業界を超えた つながりとビジネスの機会創出を促進するネットワーキン グによって構成。〈展示:東2〉

AIなど最新のテクノロジーについて幅広く

知れる・学べる、半導体エキスパートによる

業界変革の中心、アドバンストパッケージングとチップレッ

トにフォーカス。グローバルリーダーによる先端パッケージ

ングの最前線と技術の方向性、後工程自動化、ガラス基板、

若手技術者向け技術講座など。〈展示:東1~3〉

STS SEMI TECHNOLOGY SYMPOSIUM

半導体製造の国際技術シンポジウム。第一線の技術者が 「最新の技術」をテーマに企画・公演、今年で43回目を迎 えるSEMICON Japan 最大規模のフラッグシップカン ファレンス。講演に加え交流の場も提供し業界のオープン イノベーションやビジネス成長を促進する。

AI Summit & Startups

AI革命ともいえる時代が到来、展示では最先端ビジネス、 セミナーでは全体像から最新の技術応用まで、幅広くAI を俯瞰する機会を提供。〈展示:東8〉

パワーエレクトロニクス

脱炭素に向けた各国政府の規制強化、再生可能エネル ギーの需要拡大により、パワーデバイスへ設備投資が本格 化、その技術開発動向、製品戦略とは?〈展示:東3〉

量子コンピューティングフォーラム

半導体業界人のための量子コンピュータ基礎講座。開発 をリードしてきた研究者が、新技術の基礎から最先端まで を分かりやすく解説。〈展示:東8〉

Smart Manufacturing

製造プロセスの複雑化により、半導体工場では膨大なデー タが創出されている。その生産性を高めるAIを活用した データ分析ソリューションを紹介。〈展示:東6〉

EXHIBITOR'S TechSPOT

展示会場のブースだけでは得られない、出展者の製品や 技術の情報をお届けする出展者セミナー。



自由民主党 衆議院議員 自民党 経済安全保障推進本部 本部長 半導体戦略推進議員連盟 会長



Rapidus 取締役会長 技術研究組合 最先端半導体 技術センター(LSTC) 理事長



日本電信電話 (NTT) 取締役会長 澤田 純



住友商事 常務執行役員 サステナビリティ・DE&I推進グループ長 江田 麻季子

東8ホール SEMICON Al Summit & Startups Tech**STAGE** Tech**STAGE** Workforce Development エリア

Tech**STAGE**

東フホール











SEMICON[®]

詳細や来場登録は

SEMICON Japan Webサイトへ

会場のフロアマップや出展社の詳細情報は

11月に公式WEBサイトで公開予定です。

JAPAN

※2024年9月30日時点の情報です。掲載内容は 変更になる場合があります。

Workforce Development

若手支援•人材開発

これからの業界を担うZ世代応援プログラム

未来 COLLEGE (半導体業界研究イベント)

半導体関連企業50社が勢揃い!技術者から製品サービスの説明を受ける 「ブースツアー」や「スタンプラリー」など、さまざまな企画をご用意。

The 高専

高等専門学校生の若きアイディアにあふれた技術や研究成果を展示。

アカデミア

日本全国70の大学研究室による研究成果発表。産学連携や共同研究などの 機会を提供。

アカデミアAward

大学・高等専門学校の出展研究室を対象とした半導体関連の研究成果を発表 し、優れた研究を表彰するアワード。

WOMEN in BUSINESS (DE&I)

半導体企業のDE&I実現と女性リーダーシップ支援を専門家、トップリーダー が語り、業界で活躍する女性達がその実践的なアイディアを発信。

TECH CAMP

~10年後のためにイノベーションを起こそう~ 半導体産業の若手社員による 3日間のハッカソン。最終日にはステージでその成果を発表。

Special Events & Guests

スペシャルイベント&ゲスト

半導体が活躍する最新のテクノロジーの実機とスペシャルゲストによるトークイベント



AIバスケットボール ロボット CUE6 (トヨタ自動車)



落合陽一の情熱ラボ 落合 陽一



「フォルフェウス」 (オムロン)

卓球ロボット



今後大化けするかも しれない半導体勢力を



分解展示& VR体験ゾーン



WOMEN in BUSINESS The First スプツニ子!